

Title (en)

Method and apparatus for galvanizing components

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zum Galvanisieren von Bauteilen

Title (fr)

Procédé et dispositif pour galvaniser des composants

Publication

**EP 1455006 A1 20040908 (DE)**

Application

**EP 04005352 A 20040305**

Priority

DE 10310071 A 20030307

Abstract (en)

Process for galvanizing components with metallic coatings comprises moving the component to be coated through process stations using a gripper (20), and immersing in galvanic baths (29, 30). During immersion the position and/or orientation of the immersed component is changed by moving the gripper and the component is removed from the bath. An independent claim is also included for a device for carrying out the process.

Abstract (de)

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Galvanisieren von Bauteilen mit metallischen Überzügen in einem galvanischen Bad, wobei das zu beschichtende Bauteil einzeln von einem Greifer aufgenommen, in das galvanische Bad eingetaucht, während des Tauchens die Position in vorbestimmter Weise durch Bewegung des Greifers verändert und zuletzt das Bauteil aus dem galvanischen Bad entfernt wird. <IMAGE>

IPC 1-7

**C25D 17/06**; B65G 49/00

IPC 8 full level

**C25D 17/06** (2006.01); **C25D 21/10** (2006.01)

CPC (source: EP)

**C25D 17/06** (2013.01); **C25D 21/10** (2013.01)

Citation (search report)

- [X] US 6482298 B1 20021119 - BHATNAGAR PARIJAT [US]
- [XY] US 5522975 A 19960604 - ANDRICACOS PANAYOTIS C [US], et al
- [Y] US 5516412 A 19960514 - ANDRICACOS PANAYOTIS C [US], et al
- [X] US 2003034250 A1 20030220 - HEY H PETER W [US], et al
- [X] US 6309524 B1 20011030 - WOODRUFF DANIEL J [US], et al

Cited by

CN116288583A; FR3037600A1; WO2016203173A1; WO2006106118A1; US10858752B2

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

**EP 1455006 A1 20040908**; **EP 1455006 B1 20130515**; DE 10310071 B3 20040826; ES 2418806 T3 20130816

DOCDB simple family (application)

**EP 04005352 A 20040305**; DE 10310071 A 20030307; ES 04005352 T 20040305